



Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Bekanntmachung für die Förderung von innovativen Investitionsprojekten im Rahmen des Europäischen Chip-Gesetzes

Vom 6. November 2024

Die deutschen Wertschöpfungsketten sind extrem abhängig von der Mikroelektronik. Mikroelektronik ist gleichzeitig eine Voraussetzung für eine starke industrielle Wertschöpfung in Deutschland und Europa. Das betrifft sowohl die Verfügbarkeit, die Sicherheit und die Innovationskraft von mikroelektronischen Komponenten als auch von den hierfür zur Herstellung erforderlichen Materialien und Anlagen.

Insbesondere nimmt die Bedeutung der Mikroelektronik für die klima- und digitalpolitischen Herausforderungen der Zukunft immer weiter zu. Die Nutzung von erneuerbaren Energien, das Bereitstellen von öffentlicher Versorgungs- und Mobilitätsinfrastruktur sowie die Elektrifizierung des Individualverkehrs beruhen auf der vermehrten Nutzung von mikroelektronischen Systemen.

Ebenso werden die Maßnahmen zur Digitalisierung der Zukunft in den Bereichen Vernetzung, Kommunikation und Datenverarbeitung noch stärker als heute durch die Mikroelektronik dominiert. Dies beinhaltet neben Anwendungen des Mobilfunks und der Datenübertragungsnetze insbesondere auch die Bereiche des Internets der Dinge, der künstlichen Intelligenz sowie des autonomen Fahrens, das einen starken Einfluss auf die Entwicklung des 6G-Kommunikationsstandards ausübt.

Daher benötigt die deutsche und europäische Wirtschaft eine leistungsstarke und breit aufgestellte Mikroelektronikbranche. Dies ist von strategischer Bedeutung, weil die europäische digitale und grüne Transformation wesentlich neben deutlichen Leistungssteigerungen auch von der Sicherheit und verlässlichen Verfügbarkeit der Mikroelektronik abhängt.

Die Europäische Union hat das Ziel ausgegeben, den Marktanteil der Europäischen Union an den weltweiten Produktionskapazitäten für Halbleiter bis 2030 von aktuell unter 10 Prozent auf 20 Prozent zu steigern¹. Zu diesem Zweck ist die Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems² (Chip-Gesetz) am 21. September 2023 in Kraft getreten. Ziel ist es, das Halbleiter-Ökosystem in der Europäischen Union unter anderem durch Investitionen in die Ansiedlung oder Erweiterung großvolumiger Produktion für Halbleiter und von weiteren Tätigkeiten der Halbleiter-Lieferkette beziehungsweise der Halbleiter-Wertschöpfungskette umfassend zu stärken und die Versorgungssicherheit mit Halbleitern sowie die Resilienz der europäischen Wertschöpfungskette zu erhöhen.

1 Förderziel und Rechtsgrundlage

1.1 Förderziel

Die vorliegende Förderbekanntmachung dient als ein Baustein der nationalen Durchführung des Chip-Gesetzes im Hinblick auf das beabsichtigte europäische Ziel, im Bereich der Halbleitertechnologien europäische Wettbewerbs- und Innovationskapazität sicherzustellen, die Industrie an strukturelle Veränderungen anzupassen und die Resilienz und Versorgungssicherheit Europas zu stärken.

In Deutschland soll der Aufbau neuer oder der Ausbau bestehender Halbleiterfertigungskapazitäten unter Berücksichtigung der Anforderungen des Chip-Gesetzes unterstützt werden. Dabei unterscheidet das Chip-Gesetz zwischen den integrierten Produktionsstätten (Artikel 13 Chip-Gesetz) und offenen EU-Fertigungsbetrieben (Artikel 14 Chip-Gesetz). Neben der direkten Halbleiterfertigung werden auch Kapazitäten und Technologien für Aufbau- und Verbindungstechnik („Packaging, assembly and test“) sowie Kapazitäten und Technologien in vorgelagerten Gliedern der Wertschöpfungskette adressiert. Der alleinige Kapazitätsaufbau für bereits bestehende Technologien ohne zusätzliche Innovation kann nicht gefördert werden.

¹ Mitteilung der Europäischen Kommission: „Digitaler Kompass 2030: der europäische Weg in die digitale Dekade“, COM(2021) 118 final; Mitteilung der Europäischen Kommission: „Ein Chip-Gesetz für Europa“, COM(2022) 45 final.

² Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz).



Zur Erreichung der oben genannten Förderziele sollen Investitionen in den Aus- und Aufbau von Fertigungskapazitäten angeregt werden, die über den Stand der Technik in Europa hinausgehen und dem europäischen Halbleiter-Ökosystem neue Technologien zur Fertigung von Halbleitern, zu Aufbau und Verbindung von Modulen und Systemen auf Basis von Chips sowie die der Produktion vorgelagerten Glieder der Wertschöpfungskette hinzufügen.

Es sollen Investitionsprojekte aus der Industrie unter besonderer Berücksichtigung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)³ gefördert werden, die zu den genannten Förderzielen beitragen.

1.2 Rechtsgrundlage

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) als Bewilligungsbehörde aufgrund des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Nach Maßgabe dieser Förderbekanntmachung ausgewählte Einzelprojekte werden auf Grundlage der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften und vorbehaltlich der Einhaltung der beihilferechtlichen Rahmenbedingungen und Verfahren bewilligt.

Für die geplante Förderung ist ein Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission gemäß Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in Verbindung mit der Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz) durchzuführen⁴ und eine entsprechende Genehmigung der Europäischen Kommission erforderlich.

Sofern die Europäische Kommission im Rahmen des beihilferechtlichen Notifizierungsverfahrens für ein Projekt auf eine Förderung auf Grundlage der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) verweist, können Förderungen im Rahmen dieser Förderbekanntmachung auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 2c AGVO der Europäischen Kommission⁵ gewährt werden, sofern die darin aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Notifizierung der Beihilfe bei der Europäischen Kommission und die TAM-Meldung („Transparency Award Module“) nach beihilferechtlichen Vorschriften wird durch das BMWK auf Grundlage der von der Interessentin eingereichten Dokumente (vergleiche Nummer 7), soweit diese den rechtlichen Anforderungen entsprechen, vorgenommen. Die Interessentin ist im Rahmen des beihilferechtlichen Notifizierungs- beziehungsweise Anzeigeverfahrens zur Mitwirkung verpflichtet, etwa durch Beibringung notwendiger Unterlagen und Informationen.

2 Gegenstand der Förderung

Die geplanten Investitionsprojekte müssen in mindestens einem der folgenden Bereiche wettbewerbsfähige und technologisch ausgereifte Kapazitäten installieren und betreiben, die den Stand der Technik in Europa übertreffen:

- Herstellung von Rohwafern oder Fotomasken,
- Prozessierung von Halbleiterwafern („Front-End“),
- Aufbau- und Verbindungstechniken von Mikrochips und mikroelektronikbasierten Modulen oder Systemen inklusive Prüftechnologien („Back-End“),
- Herstellung von Ausrüstung oder Schlüsselkomponenten für Ausrüstung, die für Front-End- oder Back-End-Fertigung von Halbleitern benötigt wird.

Gefördert werden Einzelprojekte, die sich durch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung und auf die Resilienz des europäischen Halbleiter-Ökosystems auszeichnen. Reine Forschungs- und Entwicklungsprojekte, mit Ausnahme von Projekten, die auf Artikel 25 Absatz 2c AGVO gestützt werden können, sowie Projekte ohne den notwendigen Neuartigkeitscharakter für Europa werden nicht berücksichtigt. Zuwendungen für die Modernisierung bereits bestehender Anlagen/Geräte beziehungsweise Ersatzbeschaffungen ohne maßgeblichen Kapazitätsaufbau allein können nach Maßgabe dieser Förderbekanntmachung nicht gewährt werden.

3 Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland.

Es ist möglich, als gewerbliches Unternehmen ohne Sitz in der Bundesrepublik Deutschland an Verfahrensstufe 1 (vergleiche Nummer 7) teilzunehmen. Gleichwohl wäre in der Verfahrensstufe 2 die Gründung eines Sitzes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erforderlich.

Die Beteiligung von KMU an dieser Fördermaßnahme ist ausdrücklich erwünscht. KMU im Sinne dieser Förderbekanntmachung sind Unternehmen, die die Voraussetzungen der KMU-Definition der Europäischen Union erfüllen.⁶

³ Vergleiche Anhang I AGVO

⁴ Berücksichtigung der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen COM (2022) 45 final und anhand der Vorgaben der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 AEUV.

⁵ Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1), in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommission vom 23. Juni 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 und der Verordnung (EU) Nr. 2022/2473 (ABl. L 167 vom 30.6.2023, S. 1).

⁶ Vergleiche Anhang I AGVO.



4 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Investitionsprojekte müssen einen Neuartigkeitscharakter („First-of-a-Kind“) aufweisen, das heißt, die durch das Investitionsprojekt realisierten Technologien zur Fertigung oder Vorbereitung der Fertigung von Halbleitern, Modulen oder Systemen müssen über den Stand der Technik in Europa hinausgehen. Der Innovationscharakter ist dabei nicht allein auf die Strukturgröße der Halbleiter begrenzt. Umfasst sind auch Investitionen in Innovationen für ausgereifte Technologieknoten, insbesondere wenn ein Projekt signifikant und messbar zu anderen europäischen Zielen beiträgt. Außerdem müssen die Investitionsprojekte den weiteren Anforderungen gemäß den Artikeln 13 bis 15 sowie 26 des Chip-Gesetzes entsprechen, darunter, dass entsprechende Projekte zur Versorgungssicherheit mit Halbleitern und zur Resilienz des europäischen Halbleiter-Ökosystems beitragen, eine eindeutig positive Auswirkung mit Ausstrahlungseffekten über das Unternehmen oder den betreffenden Mitgliedsstaat hinaus in Europa haben, sich zur kontinuierlichen Investition in Innovation und zur Unterstützung der Talentpipeline der Europäischen Union verpflichten und im Krisenfall priorisierte Bestellungen akzeptieren.

Durch die Europäische Kommission werden Investitionsprojekte, die die genannten Anforderungen erfüllen, als integrierte Fertigungsstätte („integrated production facility“, IPF) gemäß Artikel 13 des Chip-Gesetzes oder als offener EU-Fertigungsbetrieb („open EU foundry“, OEF) gemäß Artikel 14 des Chip-Gesetzes zertifiziert. Die Erlangung entweder des Status einer integrierten Fertigungsstätte oder des Status eines offenen EU-Fertigungsbetriebes ist die notwendige Voraussetzung für eine Förderung im Rahmen dieser Förderbekanntmachung, unabhängig davon, ob für eine Förderung eine Einzelbeihilfegenehmigung erwirkt werden muss oder eine Förderung nach den Grundsätzen der AGVO möglich ist. Die Zertifizierung muss durch die Interessentin beantragt werden (Verfahren vergleiche Nummer 7.2.2), vergleiche hierzu den Leitfaden der Europäischen Kommission. Weitere konkrete auf den Einzelfall bezogene Voraussetzungen können sich während des gegebenenfalls notwendigen beihilferechtlichen Genehmigungsverfahrens ergeben.

Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens müssen Interessierte, für die die Genehmigung einer Einzelbeihilfe bei der Europäischen Kommission beantragt wird, eine Finanzierungslücke inklusive der Darlegung des zur Bestimmung der Finanzierungslücke angenommenen kontrafaktischen Szenarios, das Vorhandensein eines Anreizeffektes sowie die Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Beihilfe nachweisen.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

Die Zuwendung wird grundsätzlich als Projektförderung in Form einer bedingt rückzahlbaren Zuwendung gewährt. Die Rückzahlung wird durch die Einrichtung eines Rückforderungsmechanismus (sogenannter Claw-Back-Mechanismus) in Abstimmung mit der Europäischen Kommission im Rahmen des Beihilfeprozesses bedingt.

Die Höhe der Zuwendungen richtet sich

- im Fall der Notifizierung eines Einzelvorhabens bei der Europäischen Kommission nach der nachgewiesenen Finanzierungslücke (siehe Nummer 7.2.1);
- im Ausnahmefall der Förderung auf Basis der AGVO nach den zuwendungs- und beihilfefähigen projektbezogenen Ausgaben, die anteilig bezuschusst werden.

Die Zuwendung wird

- im Fall der Notifizierung eines Einzelvorhabens bei der Europäischen Kommission in Form einer bedingt rückzahlbaren Zuwendung gewährt. In diesem Fall wird eine Rückzahlung durch die Einrichtung eines Rückforderungsmechanismus (sogenannter Claw-Back-Mechanismus) bedingt.
- im Ausnahmefall der Förderung auf Basis der AGVO in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. In diesem Fall sind die beihilferechtlichen Vorgaben der AGVO (insbesondere Artikel 25 Absatz 3, 5 und 6 AGVO) zu beachten.

Die maximale Höhe einer Förderung wird durch die beihilferechtliche Genehmigung begrenzt. Erfolgt die Förderung nach Hinweis der Europäischen Kommission auf Grundlage der AGVO, so wird die Zuwendung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. In diesem Fall sind die beihilferechtlichen Vorgaben der AGVO (insbesondere Artikel 25 Absatz 3, 5 und 6 AGVO) zu beachten.

Der Zuwendungsgeber setzt einen maßgeblichen Eigenanteil an den entstehenden zuwendungsfähigen Ausgaben voraus (Anteilfinanzierung). Für KMU kann der Eigenanteil abgesenkt werden.

Der Vordruck „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis (AZA)“ des BMWK ist zu beachten. Der angestrebte Förderzeitraum ist bis 2028 beschränkt.

Bei einer Förderung wird eine Kofinanzierung der Bundesländer, in denen Projekte durchgeführt werden sollen, beabsichtigt. Das BMWK stimmt sich mit den betroffenen Bundesländern zur Länderbeteiligung ab.

Bei den Zuwendungen kann es sich um Subventionen im Sinne von § 264 Absatz 7 des Strafgesetzbuchs handeln. Die Antragsteller werden dazu im Zusammenhang mit dem Antrag über die subventionserheblichen Tatsachen informiert. Der Antragsteller muss zudem die Kenntnis der Strafbarkeit des Subventionsbetrugs und der subventionserheblichen Tatsachen auf einem dafür zur Verfügung gestellten Formular bestätigen.



6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Bestandteil eines Zuwendungsbescheids auf Ausgabenbasis werden grundsätzlich die „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung“ (ANBest-P).

Antragstellende müssen sich im Antrag auf Förderung damit einverstanden erklären und werden im Zuwendungsbescheid dazu verpflichtet, dass

- sämtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren eingereichten Unterlagen dem BMWK oder dem Projektträger zur Verfügung stehen, sie dem Bundesrechnungshof und den Prüforganen der Europäischen Union auf Verlangen erforderliche Auskünfte erteilen, Einsicht in Bücher und Unterlagen sowie Prüfungen gestatten und entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen;
- die Förderung auf Grundlage von § 44 BHO in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Nummer 9.1 und 9.2 zu § 44 BHO in einem zentralen System des Bundes erfasst wird (Zuwendungsdatenbank);
- alle im Zusammenhang mit der Förderung bekannt gewordenen Daten und Nachweise
 - von der administrierenden Stelle, dem BMWK oder einer von einem der beiden beauftragten Stelle gespeichert werden können,
 - zum Zweck der Erfolgskontrolle gemäß den Verwaltungsvorschriften nach § 7 BHO weiterverarbeitet werden können,
 - vom BMWK an zur Vertraulichkeit verpflichtete, mit einer Evaluation beauftragte Dritte weitergegeben und dort weiterverarbeitet werden können,
 - für Zwecke der Bearbeitung und Kontrolle der Anträge, der Statistik, des Monitorings, wissenschaftlicher Fragestellungen, der Verknüpfung mit amtlichen Daten, der Evaluation und der Erfolgskontrolle des Förderprogramms verwendet und ausgewertet werden,
- die anonymisierten beziehungsweise aggregierten Auswertungsergebnisse veröffentlicht und an den Bundestag und an Einrichtungen des Bundes und der Europäischen Union weitergeleitet werden können.

Der Zuwendungsempfänger wird verpflichtet, alle im Rahmen der Erfolgskontrolle benötigten und vom Zuwendungsgeber oder einer von ihm beauftragten Stelle benannten Daten bereitzustellen, an vom Zuwendungsgeber oder einer von ihm beauftragten Stelle für die Erfolgskontrolle beziehungsweise Evaluation vorgesehenen Befragungen, Interviews und sonstigen Datenerhebungen teilzunehmen und gegebenenfalls an einer vom Zuwendungsgeber beauftragten Evaluation mitzuwirken. Dies gilt auch für Prüfungen durch den Bundesrechnungshof gemäß § 91 BHO.

Die Informationen werden ausschließlich für die vorgenannten Zwecke verwendet, vertraulich behandelt und so anonymisiert veröffentlicht, dass ein Rückschluss auf einzelne Personen, Unternehmen oder Einrichtungen nicht möglich ist.

7 Verfahren

7.1 Projektträger

Zur Administration sowie fachlichen Beratung der Antragsteller bindet das BMWK folgenden Projektträger ein:

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
10623 Berlin

Zentrale Ansprechpersonen bei der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH sind:

Herr Dr. Marius Peters, Telefon: + 49 30/310078-3622 und
Herr Sebastian König, Telefon: + 49 351/486797-170
E-Mail: pt.eca@vdivde-it.de

Soweit sich hierzu Änderungen ergeben, wird dies im Bundesanzeiger oder in anderer geeigneter Weise bekannt gegeben.

7.2 Zweistufiges Verfahren

Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt. Die erste Stufe besteht aus einem nationalen Interessenbekundungsverfahren und der Einreichung von Projektvorschlägen. Die zweite Stufe beinhaltet die Antragstellung auf nationaler Ebene, die Durchführung des europäischen Beihilfeverfahrens (Notifizierung der Beihilfe beziehungsweise Anzeige der Förderung nach AGVO) und die Durchführung des europäischen Statusverfahrens zur Zertifizierung als IPF oder OEF.

Das Verfahren beginnt in der ersten Stufe mit der Einreichung eines Projektvorschlags (inklusive detaillierte Projektbeschreibung und Funding Gap Analyse, siehe Nummer 7.2.1). Die erste Stufe endet nach einer Priorisierung der Projektvorschläge mit einer Mitteilung des Prüfergebnisses der grundsätzlichen Förderfähigkeit des Projekts an die beteiligten Unternehmen. Der Projektvorschlag soll im Anschluss bei der Europäischen Kommission zur Einleitung des Beihilfeverfahrens eingereicht werden.

Wird ein eingereichter Projektvorschlag grundsätzlich als förderfähig bewertet, erfolgt in der zweiten Stufe (siehe Nummer 7.2.2) die Aufforderung zur nationalen Antragstellung. Mit Einreichung vollständiger Antragsunterlagen setzt sich das nationale Antragsverfahren fort und endet mit der Bewilligung oder Ablehnung des Förderantrags.



In Stufe 2 werden parallel das europäische Beihilfeverfahren auf Grundlage der eingereichten detaillierten Projektbeschreibung und das Statusverfahren zur Zertifizierung als IPF oder OEF durchgeführt.

Alle Unterlagen sind grundsätzlich in deutscher Sprache zu erstellen. Ausgenommen davon sind die Projektbeschreibung sowie gegebenenfalls weitere Unterlagen, die für das Beihilfeverfahren erforderlich sind. Diese sind in englischer Sprache zu erstellen.

7.2.1 Vorlage und Auswahl von Projektvorschlägen (Stufe 1)

Vorlage eines Projektvorschlags

In Stufe 1 ist dem Projektträger zunächst ein detaillierter Projektvorschlag in elektronischer Form über das elektronische Skizzentool:

<https://www.vdivde-it.de/submission/bekanntmachungen/2408>

bis spätestens 10. Januar 2025

vorzulegen. Die nach diesem Stichtag eingehenden Projektvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

Ein detaillierter Projektvorschlag besteht aus einer deutschsprachigen Kurzbeschreibung des Projekts, einer englischsprachigen Projektbeschreibung („Project Description“) sowie einer Funding Gap Analyse. Die zu verwendenden Dokumentenvorlagen werden über den oben genannten Link zur Verfügung gestellt. Für Rückfragen zu den Dokumentenvorlagen steht der Projektträger zur Verfügung und wird über oben genannten Link eine FAQ-Liste einrichten und pflegen.

Die Kurzbeschreibung sollte einen Umfang von vier DIN-A4-Seiten (Word-Format) nach der vorgegebenen Vorlage nicht überschreiten (Schriftart Arial, Schriftgröße 12 Punkt, einfacher Zeilenabstand, Rand mindestens 2 cm).

Die Project Description sollte einen Umfang von 60 DIN-A4-Seiten (Word-Format) inklusive des Deckblatts und der Anlagen nicht überschreiten (Schriftart Arial, Schriftgröße 12 Punkt, einfacher Zeilenabstand, Rand mindestens 2 cm). Des Weiteren werden in der Vorlage weitere Zeichenbeschränkungen in Anlehnung an die Anforderungen des EU-Statusverfahrens vorgegeben, um Abschnitte der Projektbeschreibung zur Beantragung des Status einer IPF beziehungsweise OEF verwenden zu können.

Die englischsprachige Project Description ist unter Anwendung der Vorlage folgendermaßen zu gliedern:

0. Deckblatt:

Angabe des Projekttitels, der antragstellenden Rechtseinheit (Unternehmen), Standort des Projekts, einer Ansprechperson (Projektleitung) inklusive Kontaktdaten (Postadresse, Telefon, E-Mail).

1. Project Outline:

In diesem Abschnitt ist ein Überblick über die Antragstellerin, die Projektinhalte, die Ziele und damit verbundenen Herausforderungen des Projekts, die Expertise der Antragstellerin auf dem technologischen Gebiet der Projektinhalte als Argument für die Durchführbarkeit und den Neuartigkeitscharakter des Projekts („first-of-a-kind-Charakter“) zu geben.

2. Investment and State Aid:

Hier sind geplante Investitionssummen für Anlagen und Gebäude für die Einrichtung einer Fertigungsstätte nach Klassifikation im Statusverfahren der Europäischen Kommission anzugeben, außerdem ein grober Finanzierungsplan, eine Angabe zur beantragten Höhe der Beihilfe und Angaben zur langfristigen Tragfähigkeit und zur Standortgarantie des Projekts.

3. Recognition as Integrated Production Facility or Open EU Foundry under the proposed Chips Act:

Hier sind in geeigneten Unterkapiteln Informationen und Angaben über die notwendigen Selbstverpflichtungen im Verfahren zur Beantragung des Status einer IPF beziehungsweise OEF anzugeben.

4. European Scope:

Hier ist ein Bezug zwischen dem Projekt und den übergeordneten Zielen des Europäischen Chip-Gesetzes herzustellen. Außerdem muss die Integration in das europäische Mikroelektronik-Ökosystem dargestellt und die Standortauswahl begründet werden.

5. Spill-over Effects:

In diesem Kapitel ist explizit auf die vier Spill-Over-Ebenen (Non-protected IP dissemination, protected IP diffusion, Access to third parties, Other) einzugehen und konkrete und detaillierte Aussagen zu den geplanten Aktivitäten zu treffen.

6. Incentive Effect:

In diesem Kapitel ist der Entscheidungsprozess bei der Entscheidung für das Investitionsprojekt darzustellen, um den Anreizeffekt zu belegen und Mitnahmeeffekte auszuschließen. In diesem Zusammenhang ist auch ein angemessenes kontrafaktisches Szenario darzustellen, das plausibel darstellt, in welchem Maße oder unter welchen Umständen – gegebenenfalls auch an welchem alternativen Standort – das Projekt ohne Förderung durchgeführt würde (und das sich auch in der Funding Gap Analyse widerspiegelt). Es muss bestätigt werden, dass mit den Arbeiten für die Realisierung des Projekts nicht vorfristig begonnen wurde und dass bisher keine Beihilfe für die



Durchführung des Projekts ausgereicht wurde. Außerdem ist zu informieren, ob im Europäischen Wirtschaftsraum ähnliche Projekte umgesetzt werden.

7. Necessity, Appropriateness and Proportionality:

In diesem Kapitel ist jeweils zu argumentieren, ob eine Beihilfe notwendig für die Projektdurchführung ist, ob eine Beihilfe in Form einer Zuwendung das angemessene Instrument ist und inwiefern im Rahmen der Funding Gap Analyse eine Verhältnismäßigkeit der Beihilfe gewährleistet wird. Bei Projekten, die eine Förderung im Rahmen einer Einzelbeihilfe beantragen, ist außerdem die Verpflichtung zu einem Rückforderungsmechanismus aufzunehmen.

8. Elaboration on the Parameters of the Business Plan/Funding Gap Questionnaire:

Dieses Kapitel der Projektbeschreibung ist als direkte Erläuterung der Angaben in der Excel-Tabelle „Funding Gap Analyse“ (siehe unten) zu verstehen.

9. Market research & distortion of competition and trade:

In diesem Kapitel ist aufzuführen, wie sich das Projekt in eine zukünftige Marktconstellation einfügen wird, mit welchen Wettbewerbern vor allem innerhalb der Europäischen Union gerechnet wird und ob diese bereits jetzt durch eine staatliche Beihilfe zu Ihrem Projekt einen Nachteil erleiden. Einen derartigen Nachteil hätte ein Bewerber etwa, wenn wahrnehmbare Aktivitäten in diesem Geschäftsfeld bereits existieren, jedoch keine Beihilfe gewährt wird; oder wenn eine Beihilfe dazu führt, dass sich Marktanteile in einem gesättigten Markt, in dem alle aktuellen und entstehenden Bedarfe bereits durch bestehende Kapazitäten gedeckt werden, verschieben.

10. Annexes to the Project Description:

Hier sind zusätzliche Erläuterungen und Dokumente zu den vorhergehenden Abschnitten der Projektbeschreibung anzufügen.

Die Funding Gap Analyse (Excel-Format) dient der Berechnung der Finanzierungslücke (funding gap). Der Berechnung der Finanzierungslücke liegen zahlreiche Annahmen zugrunde, wie beispielsweise die Höhe der anrechenbaren Projektausgaben, die geplanten Absatzzahlen und Verkaufspreise oder auch der Ansatz zum Ermitteln des Restwerts von Investitionen. Grundsätzlich ist eine Nachvollziehbarkeit der angegebenen Zahlen und Berechnungsmethoden und -ansätze durch Evidenzen herzustellen, wie beispielsweise nachgewiesene Markttrends, marktübliche Gegebenheiten oder Vorverträge mit Kunden.

Auswahlentscheidung und Prüfkriterien

Die Projekte, die die formalen Kriterien dieser Förderbekanntmachung erfüllen (zum Beispiel Antragsberechtigung und Vollständigkeit der einzureichenden Unterlagen), kommen in die Auswahl.

Die Entscheidung über die Weiterverfolgung eines Projekts trifft das BMWK. Alle Unternehmen, die Projekte eingereicht haben, werden nach Abschluss der ersten Verfahrensstufe schriftlich über das Ergebnis informiert.

Es wird den Unternehmen dringend empfohlen, erst nach positiver Rückmeldung am Ende der ersten Verfahrensstufe am Statusverfahren der Europäischen Kommission (siehe Nummer 4) teilzunehmen.

Die eingegangenen Projektbeschreibungen stehen untereinander im Wettbewerb. Es werden auf Grundlage der in den Nummern 1 und 2 dargestellten Förderziele und Fördergegenstände folgende Kriterien bei der Bewertung angelegt:

- a) Grundlegende Anforderungen des Europäischen Chip-Gesetzes; Neuheit und Innovationshöhe (Beitrag zur Versorgungssicherheit und zum Ziel von 20 Prozent der weltweiten Fertigungskapazitäten im Jahr 2030; Übertreffen des Stands der Technik in Europa, Status IPF/OEF)
- b) Auswirkungen auf das Europäische Ökosystem (Positive Auswirkungen auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette in Europa, Spill-Over-Aktivitäten, Verwertung, Aufbau von Arbeitsplätzen und Standortgarantien, Beitrag zur Abwendung von Krisen)
- c) Darstellung des kontrafaktischen Szenarios
- d) Nachhaltigkeit des Projekts (Nachhaltiges Bauen und weitere Nachhaltigkeitsindikatoren im Betrieb)
- e) Plausibilität und Erfolgsaussichten der Projektbeschreibung unter Berücksichtigung der gesetzten Zeit- und Ressourcenplanung sowie des kontrafaktischen Szenarios
- f) Projektrealisierung durch ein gewerbliches Unternehmen mit angemessener Expertise im adressierten Themenbereich

Die Förderung setzt eine positive Begutachtung der detaillierten Projektbeschreibung voraus. Entsprechend den oben angegebenen Kriterien und der Bewertung werden die für eine Weiterverfolgung geeigneten Projekte ausgewählt.

7.2.2 Beihilfeverfahren und Einreichung förmlicher Förderanträge und Entscheidungsverfahren (Stufe 2)

Nachdem die Projekte zur Weiterverfolgung ausgewählt wurden (positive Mitteilung nach Ende der Stufe 1), werden die ausgewählten Projektvorschläge mit der detaillierten Projektbeschreibung und der Funding Gap Analyse bei der Europäischen Kommission mit dem Ziel einer beihilferechtlichen Genehmigung pränotifiziert.⁷ Hierzu könnten gegebenenfalls noch Überarbeitungen der Dokumente notwendig sein. Die Anmeldung zum Beihilfeverfahren erfolgt durch das BMWK. Im Rahmen des Pränotifizierungsverfahrens erfolgt durch die Antragsteller eine Überarbeitung der ein-

⁷ Im Ausnahmefall einer Förderung auf Grundlage der AGVO erfolgt die Anzeige der Förderung bei der Europäischen Kommission.



gereichten Dokumente nach den Hinweisen der Europäischen Kommission. Aus der Einleitung eines Beihilfeprozesses bei der Europäischen Kommission kann kein Rechtsanspruch auf Förderung abgeleitet werden.

Parallel erfolgt die Anmeldung zum Statusverfahren zur Zertifizierung als IPF oder OEF bei der Europäischen Kommission durch die Antragsteller. Aus der Erreichung eines EU-Status als IPF oder OEF kann kein Rechtsanspruch auf Förderung abgeleitet werden.

Die nationale Antragstellung erfolgt nach Aufforderung durch das BMWK über das Antragsportal easy-Online.

Die endgültige Entscheidung über die Förderung trifft das BMWK in der zweiten Verfahrensstufe – bei Einzelbeihilfen nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäischen Kommission – nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel, der förderpolitischen Zielsetzung und nach Maßgabe der zuwendungsrechtlichen Bestimmungen.

7.3 Informationsveranstaltung

Eine virtuelle Informationsveranstaltung zu der hier vorliegenden, nationalen Förderbekanntmachung findet am 25. November 2024 statt. In dieser Veranstaltung werden der Inhalt der Förderbekanntmachung sowie der Prozess und das Verfahren der Antragstellung erläutert sowie Fragen beantwortet. Informationen zu dieser Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten interessierte Unternehmen unter <https://ssl.vdivde-it.de/registrations/3300>.

Berlin, den 6. November 2024

Bundesministerium
für Wirtschaft und Klimaschutz

Im Auftrag
Ramona Frick
